

「EP8000 シリーズ」に POWER5 プロセッサを搭載した新モデルをラインアップ
最新版 OS「AIX 5L version 5.3」を採用し、ハードウェア資源仮想化機能、オンデマンド機能を強化



EP8000 570

日立製作所 情報・通信グループ(グループ長&CEO:古川 一夫、以下、日立)は、このたび、米国 IBM 社の UNIX オペレーティングシステム(OS)である AIX 5L を搭載したエンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」に新プロセッサ POWER5 を搭載した新モデル3機種および最新版 OS「AIX 5L version 5.3」を製品化し、7月20日から販売開始します。

EP8000 シリーズは、米国 IBM 社の UNIX オペレーティングシステム(OS)である AIX 5L を搭載した UNIX サーバです。

今回、大幅な性能向上と機能強化を図った POWER5 プロセッサ を採用したミッドレンジモデル「EP8000 570」とエントリーモデル「EP8000 550」「EP8000 520」をラインアップに追加し、POWER5 搭載モデルの性能・機能を最大限に引き出す最新版 OS「AIX 5L version 5.3」を製品化しました。

POWER5 搭載モデルと「AIX 5L version 5.3」の組み合わせにより、処理性能の向上に加え、プロセッサ能力のパーティションへの割当てを 1/10 プロセッサという論理的な単位で可能とするなどのハードウェア資源仮想化機能や、業務量の増加に合わせ一時的にプロセッサの処理能力増強を可能とするオンデマンド機能の強化を図っています。これらにより、システムリソースの有効活用ができ、TCO の削減とビジネス規模の変化への迅速な対応を実現します。

「EP8000 シリーズ」は、ワークグループサーバなどの小規模システムから全社レベルの大規模基幹システムまで、様々な顧客ニーズにより幅広く対応し、これからの情報化社会の基盤を支えるプラットフォームとして利用できます。

なお、今回の製品は、お客様がリソースをコアビジネスに集中し、高信頼性かつビジネスの変化に即応した最適なシステムを構築できる環境を提供する日立のサービスプラットフォームコンセプト Harmonious Computing に基づいています。

新製品の概要

モデル	形状	プロセッサ (周波数)	プロセッサ数	キャッシュメモリ	メモリ容量	拡張 PCI スロット数
EP8000 570	ラックマウント	POWER5 (1.65/1.9GHz)	2 ~ 16	レベル 2 キャッシュ: 1.9MB	2GB ~ 512GB	最大 163
EP8000 550	ラックマウント /タワー	POWER5 (1.65GHz)	2, 4	レベル 3 キャッシュ: 36MB (2 プロセッサあたり)	1GB ~ 64GB	最大 61
EP8000 520	ラックマウント /タワー	POWER5 (1.65GHz)	2		1GB ~ 32GB	最大 34

新製品の価格・出荷時期

モデル	形状	価格	出荷時期
EP8000 570	ラックマウント	9,392,250 円 ~ (税抜 8,945,000 円 ~)	2004 年 9 月 24 日
EP8000 550	ラックマウント /タワー	4,971,750 円 ~ (税抜 4,735,000 円 ~)	2004 年 9 月 10 日
EP8000 520	ラックマウント /タワー	2,892,750 円 ~ (税抜 2,755,000 円 ~)	2004 年 9 月 24 日

OS の「AIX 5L version 5.3」は、ハードバンドルとなります。

他社商標注記

- ・AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp. の登録商標です。
- ・POWER5 は、米国における米国 International Business Machines Corp. の商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

製品情報

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/EP8000>

取扱事業部・照会先

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ
 エンタープライズサーバ事業部 企画部【担当:喜多村】
 〒259 - 1392 神奈川県秦野市堀山下1番地
 電話: 0463 - 87 - 6786(ダイヤルイン)

以上

「EP8000 570」「EP8000 550」「EP8000 520」の特長

1. 新プロセッサ、最新版 OS を採用した新世代の EP8000 シリーズ

「EP8000 570」「EP8000 550」「EP8000 520」は、新プロセッサPOWER5および最新版OS「AIX 5L version 5.3」の採用により、処理性能向上とマイクロパーティショニング、LAN/ストレージ仮想化など LPAR^{*1}新機能による仮想化機能強化、リザーブCoD^{*2}によるオンデマンド機能強化を図った新世代のモデルです。

新プロセッサPOWER5は、プロセッサの利用効率を高めるSMT (Simultaneous Multi-Threading)など最新の技術を採用し大幅な性能向上を実現しています。SMTは、1つのプロセッサを論理的に2つのプロセッサとして利用することができ、これによりプロセッサあたり約20%~40%の実効性能向上を実現します。

(1) ミッドレンジモデル 「EP8000 570」の特長

「EP8000 570」は、POWER5(1.65/1.9GHz)を SMP^{*3} 構成で最大 16way まで搭載可能なミッドレンジクラスのラックマウントサーバです。従来の 16way モデル「EP8000 670」に対し、OLTP 性能で最大約 1.7 倍 (SMT 使用時)の性能向上を実現しています。

スケーラブルなシステム構築を実現するスタックブル SMP 構成を採用しており、基本ブロックとなる 4way 構成の CPU ドロウ - を最大 4 つまで接続することにより 16way SMP 構成まで拡張可能で、業務の規模や処理量に応じて、最適なコストでシステム導入および拡張が行えます。

性能だけでなく、メモリは最大 512GB、PCI スロットは最大 163 スロットまで増強できるなど、非常に高い拡張性を備える「EP8000 570」は、中規模業務システムから大規模データベース、OLTP^{*4}、データウェアハウスなどに最適なモデルです。

(2) エントリーモデル 「EP8000 550」の特長

「EP8000 550」は、POWER5(1.65GHz)を SMP 構成で最大 4way まで搭載可能なエントリークラスのサーバです。従来の 4way モデル「EP8000 630」に対し、OLTP 性能で最大約 2 倍 (SMT 使用時)の性能向上を実現しています。

システム装置はラックマウント型とタワー型の 2 種類を用意。マシンルームからオフィスまで、設置場所に応じてお選び頂けます。

メモリは最大 64GB、PCI スロットは最大 61 スロットまで増強でき、エントリーモデルながらミッドレンジクラスの拡張性を備える「EP8000 550」は、小規模から中規模の業務システム、データベース、OLTP などに最適です。

(3) エントリー - モデル 「EP8000 520」の特長

「EP8000 520」は、POWER5(1.65GHz)を SMP 構成で 2way 搭載したエントリークラスのサーバです。従来の 2way モデル「EP8000 615」に対し、OLTP 性能で最大約 2 倍 (SMT 使用時)の性能向上を実現しています。「EP8000 550」と同様、ラックマウント型とタワー型の 2 種類を用意しています。

メモリは最大 32GB、PCI スロットは最大 34 スロットまで増強できるなど、2way エントリーモデルとして非常に高い拡張性を備えており、小中規模の業務システム、データベースなどに最適なモデルとなっています。

*1) LPAR: Logical Partition

*2) CoD: Capacity on Demand

*3) SMP: Symmetric Multi-Processor

*4) OLTP: On-Line Transaction Processing

2. 最新版 UNIX OS AIX 5L version 5.3

「AIX 5L version 5.3」は、POWER5 搭載モデルの性能・機能を最大限に引き出す最新版 OS です。

「AIX 5L version 5.3」は、POWER5 の SMT やマイクロパーティショニング、LAN 仮想化/ストレージ仮想化などのハードウェア資源仮想化機能、および新しいオンデマンド機能などに対応し、POWER5 搭載モデルの性能・機能を最大限に発揮します。

もちろん従来の AIX 5L 同様、優れたパフォーマンス、信頼性・可用性、Linux との高い親和性に加え、セキュリティや Java 実行環境などネットビジネス構築のためのオープンかつミッションクリティカルな基盤機能も提供します。ミドルウェア/アプリケーションには、基幹業務システムで実績のある日立オープンミドルウェアに加え、DBMS^{*5} 製品 Oracle^Rや SAP^R R/3^Rを含む SAP の E ビジネスプラットフォーム mySAP.com^Rなど豊富な ISV^{*6} 製品がご利用頂け、幅広いニーズに対応したシステムを構築することが可能です。

*5) DBMS: Database Management System

*6) ISV: Independent Software Vendor

3. ハードウェア資源仮想化機能、オンデマンド機能を強化

POWER5 搭載モデルでは、「AIX 5L version 5.3」との組み合わせにより、処理性能の向上に加え、ハードウェア資源仮想化機能の強化、オンデマンド機能の強化を図っています。

ハードウェア資源仮想化機能の強化では、マイクロパーティショニング機能や、LAN、ストレージの仮想化機能を新たにサポートしました。

システムリソースを動的に複数のパーティションに割り当てることができる動的論理分割機能(Dynamic LPAR)では、従来、パーティションへのプロセッサ能力の割り当ては 1 プロセッサ単位でしたが、POWER5 搭載モデルでは新たにマイクロパーティショニング機能をサポートし、1/10 プロセッサという論理的な単位できめ細かく、かつ負荷に応じて自動的にパーティション間のプロセッサ能力の割り当てを行えます。

さらにパーティション間での LAN アダプタ、ディスク/ディスク接続アダプタの共有や、パーティション間高速通信を可能とする LAN 仮想化・ストレージ仮想化の機能もサポートしました。

これらハードウェア資源仮想化機能により、プロセッサ性能のより有効な活用、容易かつ迅速なパーティション間での LAN/ディスクの増設・構成変更が可能となりシステムの TCO 削減を実現します。

また、オンデマンド機能の強化では、「EP8000 570」「EP8000 550」において、お客様の業務量に応じて段階的にプロセッサの処理能力を増強できる CUoD(Capacity Upgrade on Demand)に加え、ビジネス環境の変化に迅速に対応する新 CoD 機能である「リザーブ CoD」機能をサポートしました。業務負荷にあわせ一時的にプロセッサの処理能力を増強することが可能なため、お客様のハードウェア資源の投資を最適化することができます。

4. メインフレームクラスの信頼性と可用性

「EP8000 570」「EP8000 550」「EP8000 520」は、従来モデルがサポートしていた動的プロセッサ切り離し機能、PCI バス障害回復機能、動的 PCI アダプタ切り離し機能などに加え、システムクロックの二重化、PCI ブリッジ障害によるシステムリブートを回避しシステムの処理を続行する PCI ブリッジ動的切り離し機能、ファームウェアの一部稼動中更新などの高信頼化機能をサポート。これによりシステム停止につながる障害発生を大幅に低減します。

また、「EP8000 シリーズ」はハードウェアとしてだけでなく、システムとしても高い信頼性・可用性を備えています。

高可用性ソフトウェア HA モニタとスケラブルデータベース HiRDB によるクラスタ構成において、現用系システムの OS 障害発生と同期した待機系システムへの即時切替通知や、現用系システムから待機系

システムへの共有ディスクの高速切替えを実現するソフトウェア HA Booster Pack for AIX を用いることにより、従来、数分オーダーの時間を必要とした障害時のシステム系切替を 10 数秒という極めて短い時間に実行することができます。

「EP8000 570」「EP8000 550」「EP8000 520」は、非常に高いミッションクリティカル性を要求されるシステムにも十分に対応し、お客様の業務システムとビジネスに、「安心」と「発展」を提供します。

高信頼性を支える多彩なサポートサービス

「EP8000シリーズ」のサポートサービスでは、お客様のニーズに対応したハードウェア、OS 一体のトータルサービスをワンストップで提供します。

問合せ応答、問題解決支援、更新版提供、予防保守情報提供などの基本サービスに、環境ヘルスチェックや万一の障害発生時の迅速な復旧支援や対策、長期保証(OSバージョン固定の長期保守サービス)といった高度サポートサービスオプション商品や、サポート時間を延長するオプション商品を自由に組み合わせる選択することができます。

これにより、サービスレベルやオプションメニューを柔軟に組み合わせ、お客様のシステムに合った最適なサービスを提供します。

他社所有商標に関する表示

- ・AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・POWER5 は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- ・Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは、米国及びその他の国における米国 Sun Microsystems , Inc.の商標または登録商標です。
- ・Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- ・Oracle は、Oracle Corporation の登録商標です。
- ・SAP[®]、R/3[®]、mySAP.com[®]は、SAP AG のドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

新製品の仕様

モデル		EP8000 570
形状		ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5
	クロック・レート (GHz)	1.65/1.9
	プロセッサ数 (way)	2 ~ 16 *3
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2プロセッサあたり)
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2プロセッサあたり)
主記憶容量	最小 ~ 最大(GB) *1	2 ~ 512 *3
ディスク容量	最小 ~ 最大(GB) *2	36 ~ 38,755 *3 *4
拡張PCI-Xスロット本数		6 (CPUドロー - あたり) 7 (I/Oドローあたり(ディスクベイ有の場合))
CPUドロー - 数		1 ~ 4
I/Oドロー数		0 ~ 20
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	483×790×174.1 (4EIA *5)
	I/Oドロー(ディスクベイ無)	217×711×168 (4EIA *5 *6)
	I/Oドロー(ディスクベイ有)	482×610×178 (4EIA *5)
	搭載筐体	標準ラック筐体/低層ラック筐体 *7
電源(V)		200 ~ 240 (単相)
省エネ法に 基づく表示	エネルギー消費効率	0.080
	区分	F
搭載OS		AIX 5L version 5.3 または AIX 5L version 5.2

モデル		EP8000 520		EP8000 550	
形状		タワー	ラックマウント	タワー	ラックマウント
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER5		POWER5	
	クロック・レート(GHz)	1.65		1.65	
	プロセッサ数(way)	2		2, 4	
レベル2キャッシュ(MB *1)		1.9 (2プロセッサあたり)		1.9 (2プロセッサあたり)	
レベル3キャッシュ(MB *1)		36 (2プロセッサあたり)		36 (2プロセッサあたり)	
主記憶容量	最小 ~ 最大(GB) *1	1 ~ 32		1 ~ 64	
ディスク容量	最小 ~ 最大(GB) *2	36 ~ 1,174	36 ~ 8,220 *8	36 ~ 1,174	36 ~ 15,267 *9
拡張PCI-Xスロット本数		6	6 ~ 34 *8	5	5 ~ 61 *9
I/Oドロー数		-	0 ~ 4	-	0 ~ 8
外形寸法 (W×D×H:mm)	CPUドロー	-	437×508×178 (4EIA *5)	-	437×731×178 (4EIA *5)
	I/Oドロー	-	482×610×178 (4EIA *5)	-	482×610×178 (4EIA *5)
	搭載筐体	203×584×537	標準ラック筐体/ 低層ラック筐体 *7	201×779×533	標準ラック筐体/ 低層ラック筐体 *7
電源(V)		100 ~ 127/200 ~ 240 (単相)		100 ~ 127 *10 /200 ~ 240 (単相)	
省エネ法に 基づく表示	エネルギー消費効率	0.040		0.047	
	区分	F		F	
搭載OS		AIX 5L version 5.3 または AIX 5L version 5.2			

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

*1: 1MB(メガバイト)=1,024² バイト, 1GB(ギガバイト)=1,024³ バイトです。 *2: 1GB(ギガバイト)=1,000³ バイトです。

*3: CPUドロー-4台接続時。 *4: I/Oドロー - (ディスクベイ有)20台接続時。

*5: ラック搭載時の占有サイズ(1EIA=高さ約44.5mm)。 *6: 4EIAのラックスペースに2台並べて搭載します。

*7: ラック筐体は、下記のうちから選択できます。

23EIAラック筐体(格納サイズ23EIA)外形寸法 647×1,138×1,193(W×D×H:mm)

36EIAラック筐体(格納サイズ36EIA)外形寸法 647×1,138×1,798(W×D×H:mm)

42EIAラック筐体(格納サイズ42EIA)外形寸法 647×1,138×2,015(W×D×H:mm)

*8: I/Oドロー - 4台接続時。 *9: I/Oドロー - 8台接続時。

*10: 2way構成時のみ。

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
